

表面処理技術のさらなるグローバル展開をめざして

第51期・2011年3月期第2四半期

決算説明会資料

JCU(荏原ユージライト株式会社)

東証1部 4975

2010年11月25日(木)

<http://www.jcu-i.com/>



● 2011年3月期第2四半期決算概況

● トピックス

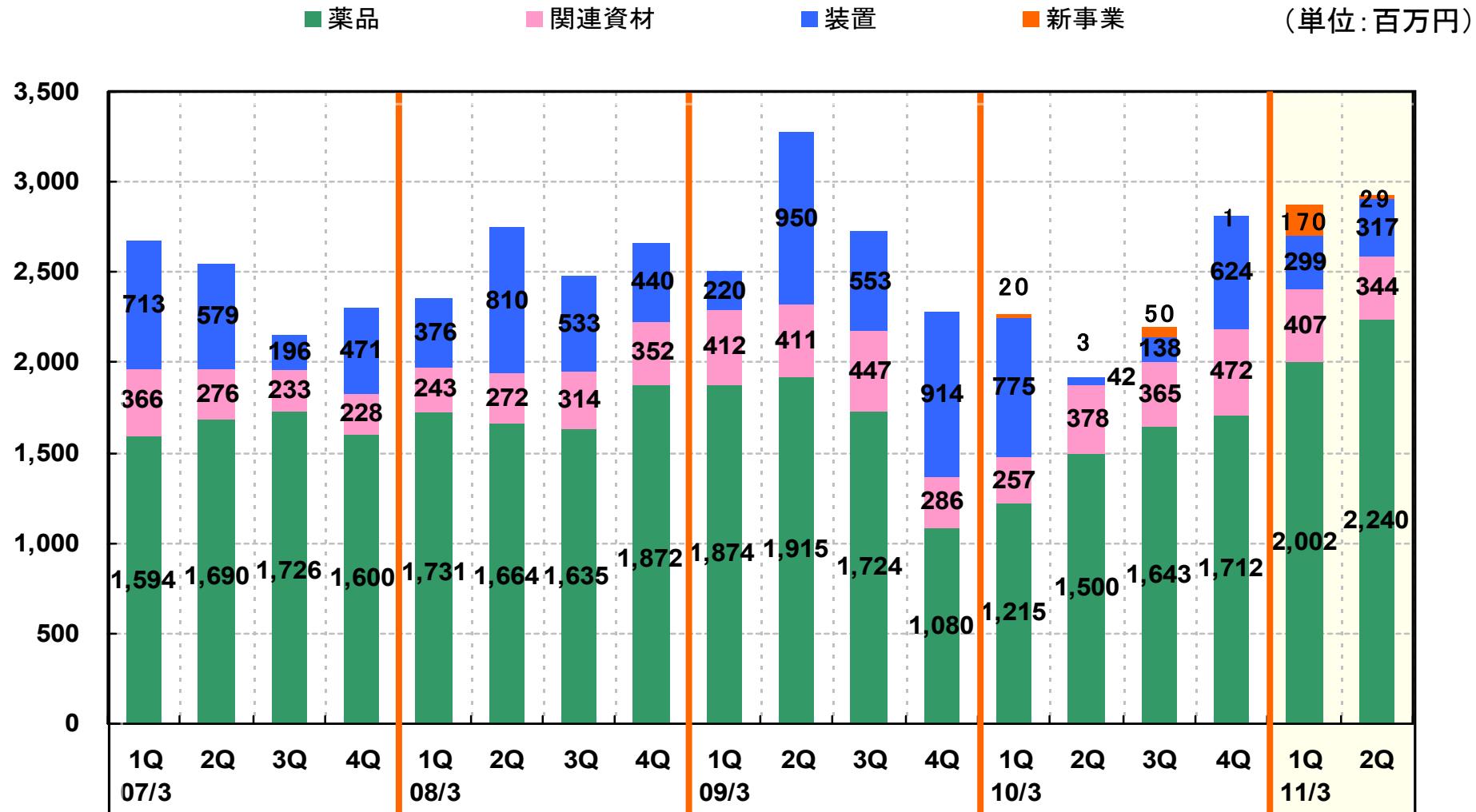


2011年3月期第2四半期業績概況

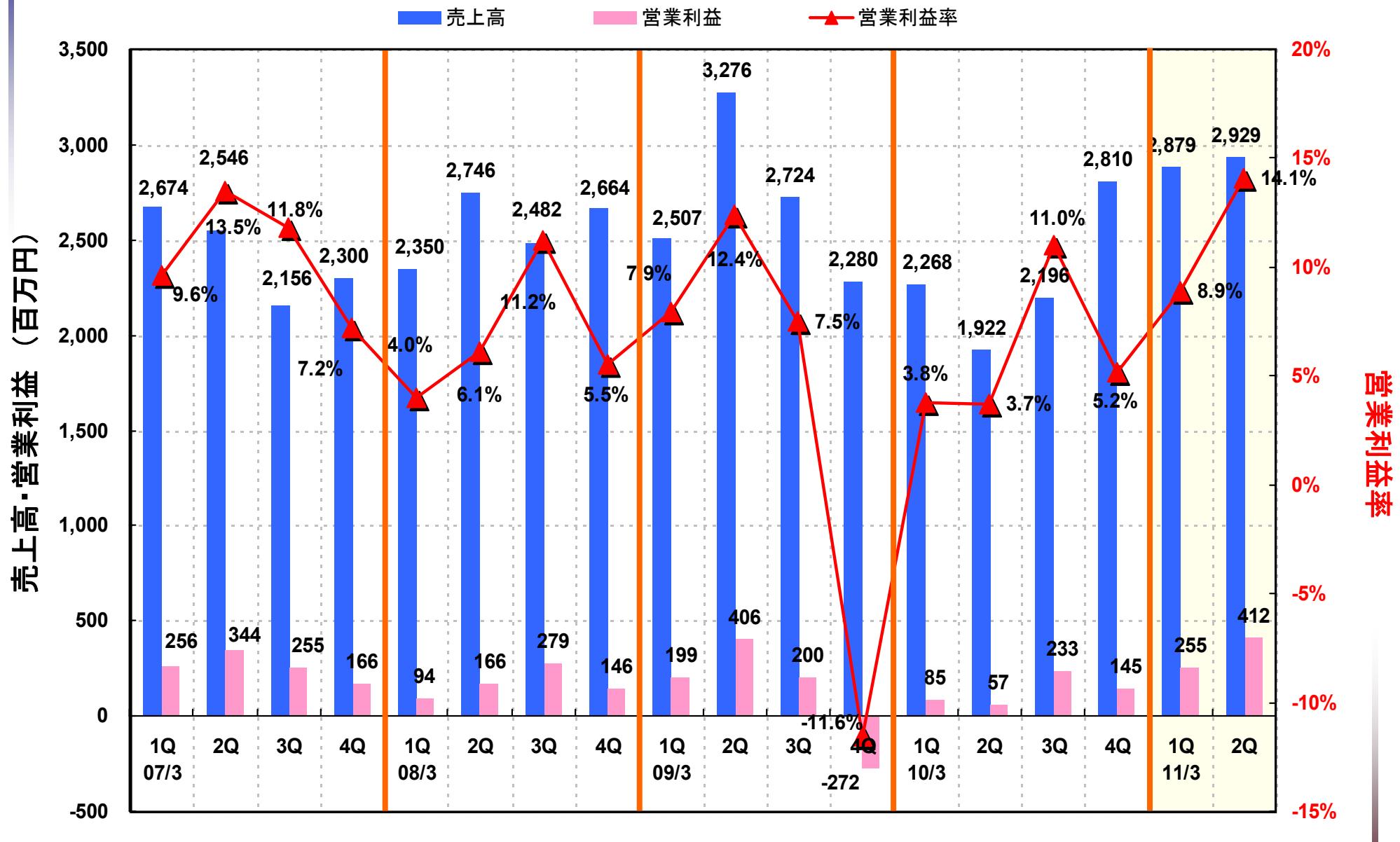


(百万円)	10／3月期 2Q単独	11／3月期 2Q単独	対前年比 増減(%)	10／3月期 2Q累計	11／3月期 2Q累計	対前年比 増減(%)
売 上 高	1, 922	2, 929	52.4%	4, 191	5, 809	38.6%
売上総利益	946	1, 558	64.5%	1, 889	2, 959	56.6%
販管費	889	1, 145	28.8%	1, 742	2, 287	31.3%
営業利益	57	412	616.0%	147	672	356.1%
経常利益	71	373	419.5%	193	660	242.1%
税引前利益	△0	313	-	90	531	487.2%
(当期)純利益	12	255	1943.2%	59	319	432.4%

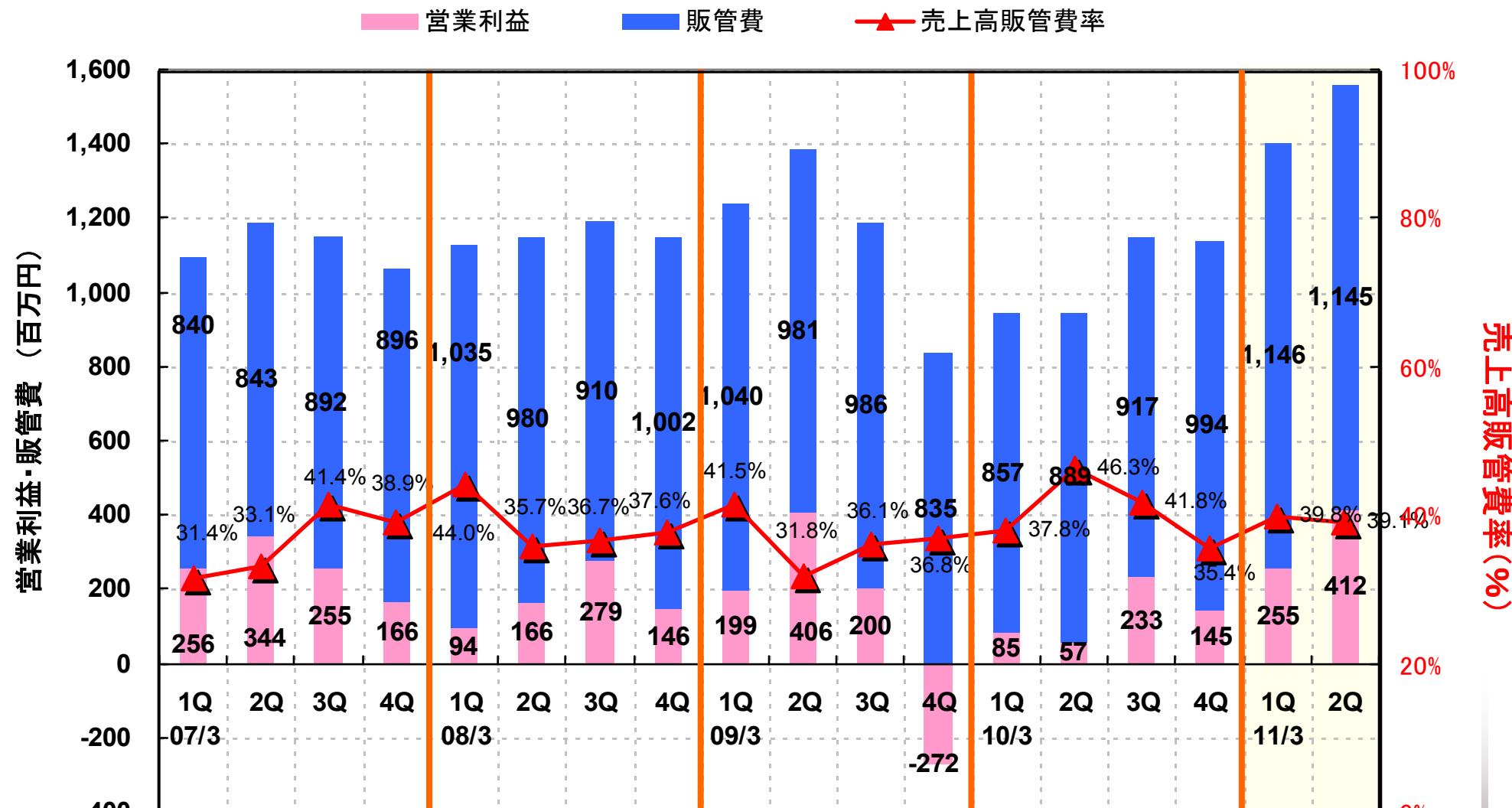
四半期別製品構成別売上高推移



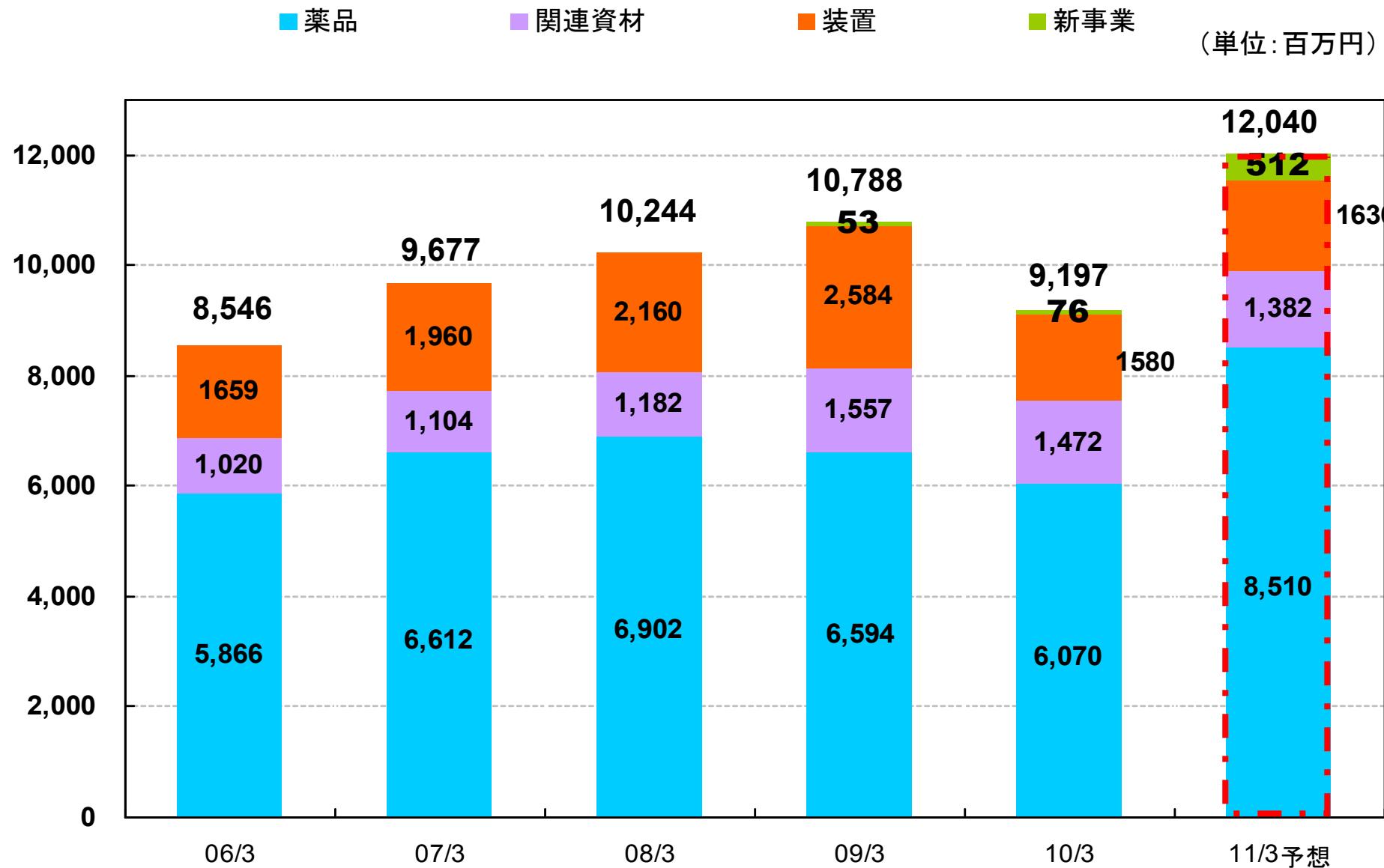
四半期別売上高・営業利益・営業利益率推移



四半期別営業利益及び販管費の推移



年度別製品構成別売上高推移



主要製品の紹介

薬品関連

基幹向け薬品	自動車業界 水栓金具業界 建築業界	自動車部品(フロントグリル、ドアハンドル等) 水栓金具(給水機器、排水栓等) 建築部品(ボルト、ナット等)
電子向け薬品	エレクトロニクス業界	プリント配線板(両面板、多層板、ビルトアップ配線板、パッケージ基板等) 電子部品(リードフレーム、チップ部品、コネクター等) 半導体(シリコンウェハ)

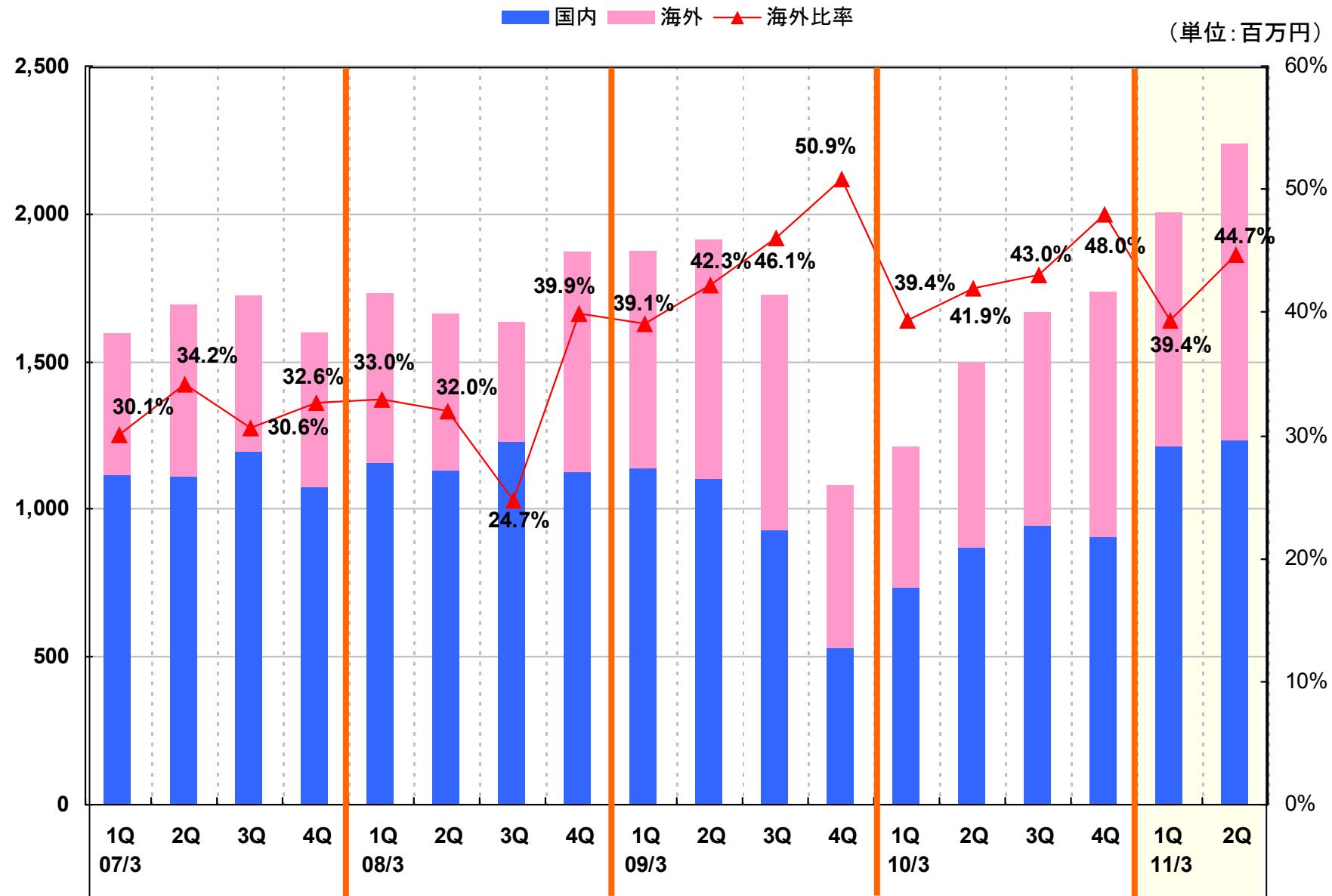
装置関連

全自動表面処理装置	自動車産業 水栓金具業界 建築業界 エレクトロニクス業界	素材の投入からめっきの完成まで自動運転をする装置
ろ過機		ろ過機製造販売 めっき液の精密ろ過をする装置
環境関連装置		環境関連装置の製造販売 太陽光発電装置や排水処理装置
自動分析管理装置		めっき液の濃度を分析し不足分を補給して、自動で管理する装置
プラズマ処理装置		プリント配線板のめっき前処理用等の洗浄処理装置

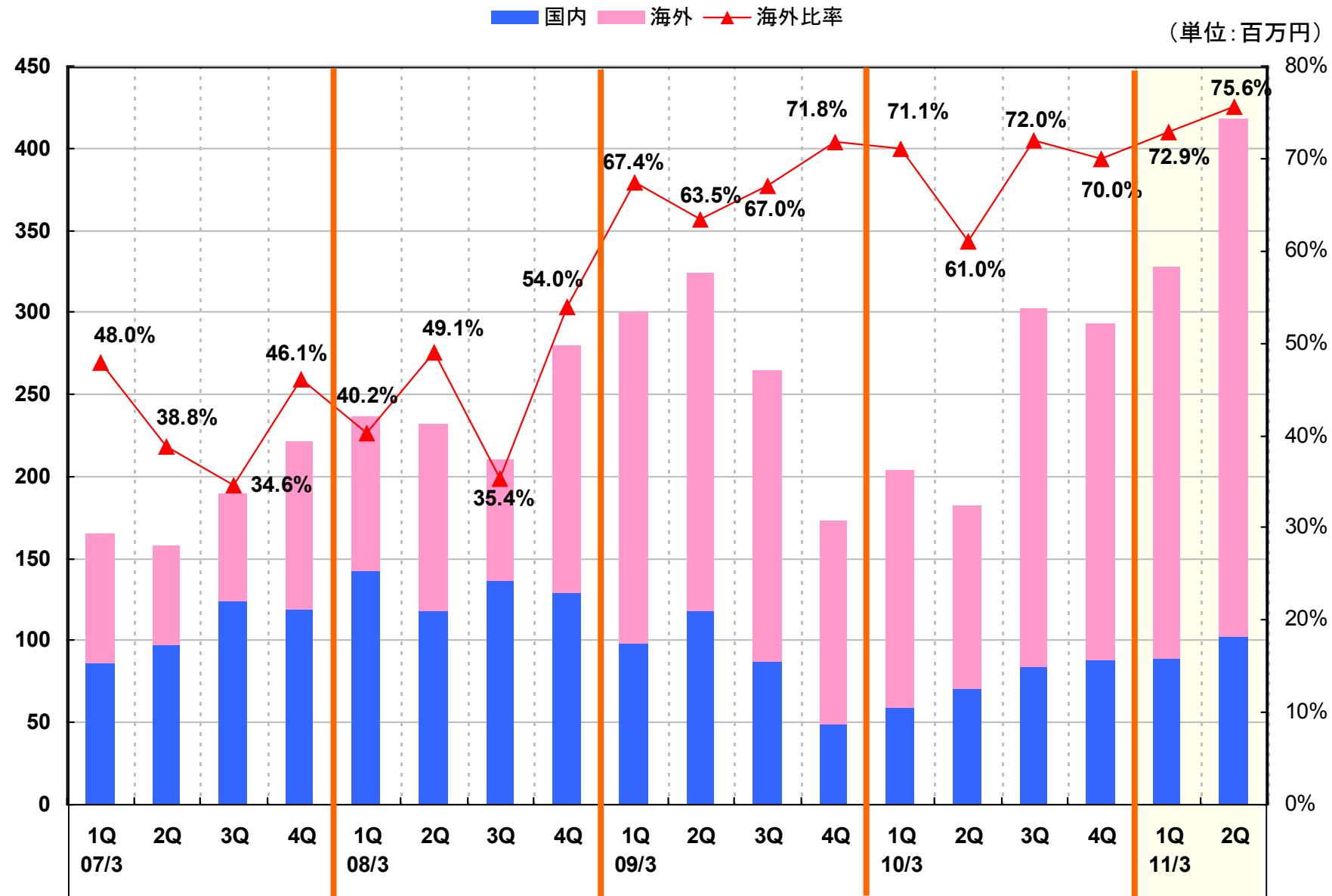
合弁会社による新事業

カラーリング加工請負	スパッタリング装置により部品のカラーリング加工を請負うもの
コーティング薬剤の販売	太陽光パネル、ボルト・ナット等に適用する新機能コーティング材料の販売

薬品全体の国内・海外マーケット別売上高推移



主力製品ビアフィル用薬品国内・海外マーケット別売上高推移

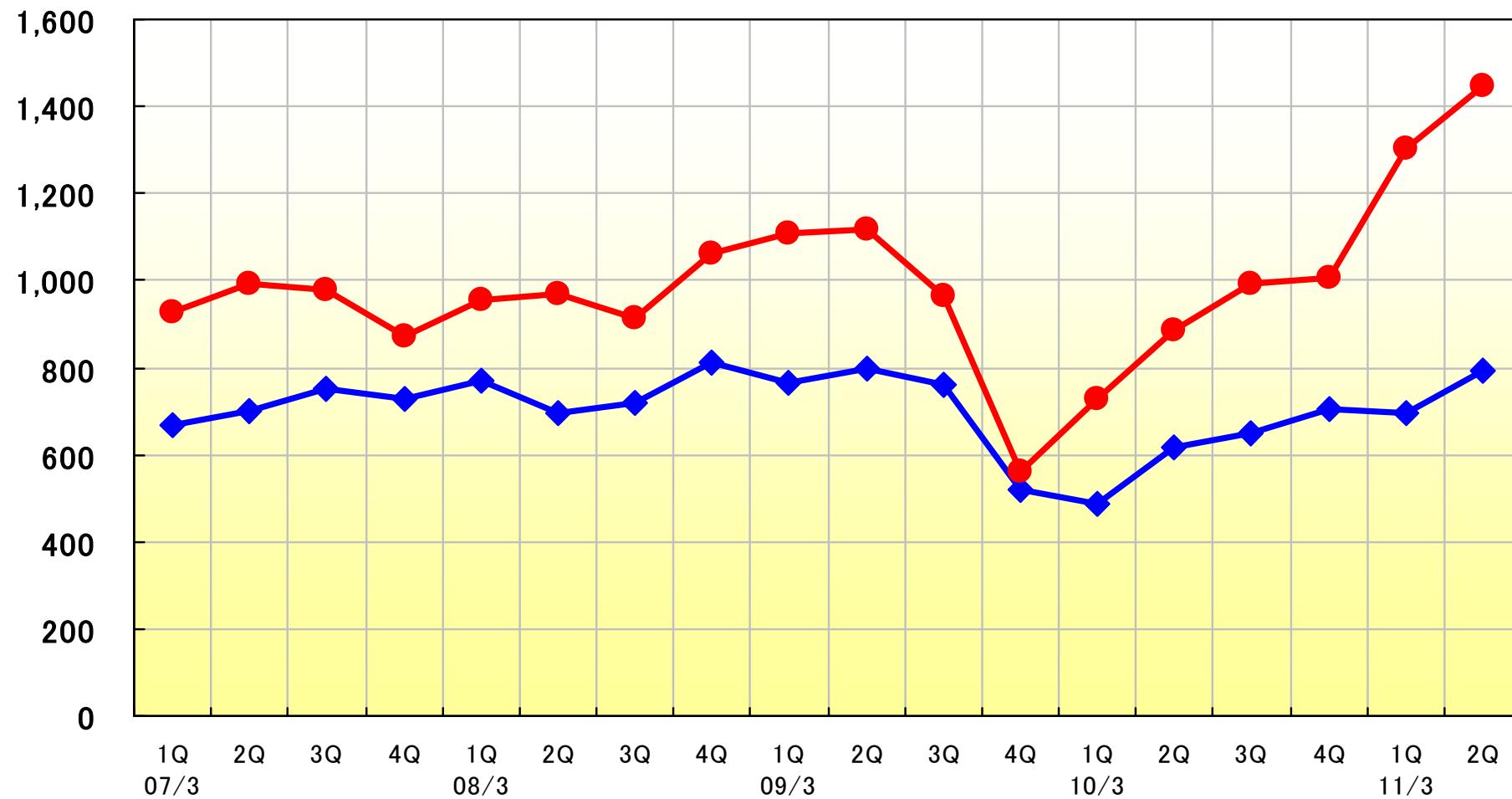


分野別薬品売上高推移: 連結全体



基幹薬品 電子薬品

(単位:百万円)

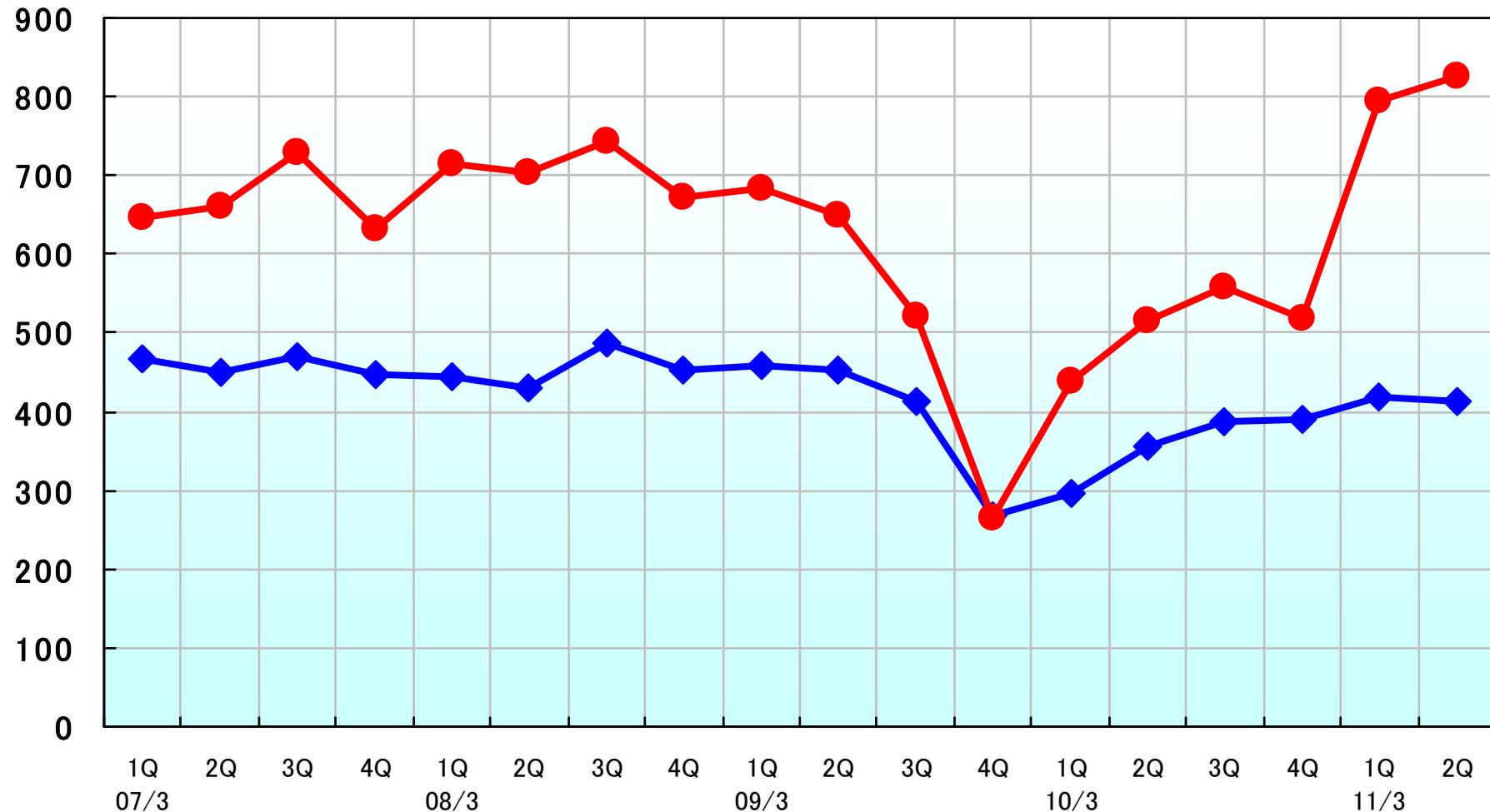


分野別薬品売上高推移:国内マーケット



基幹薬品 電子薬品

(単位:百万円)

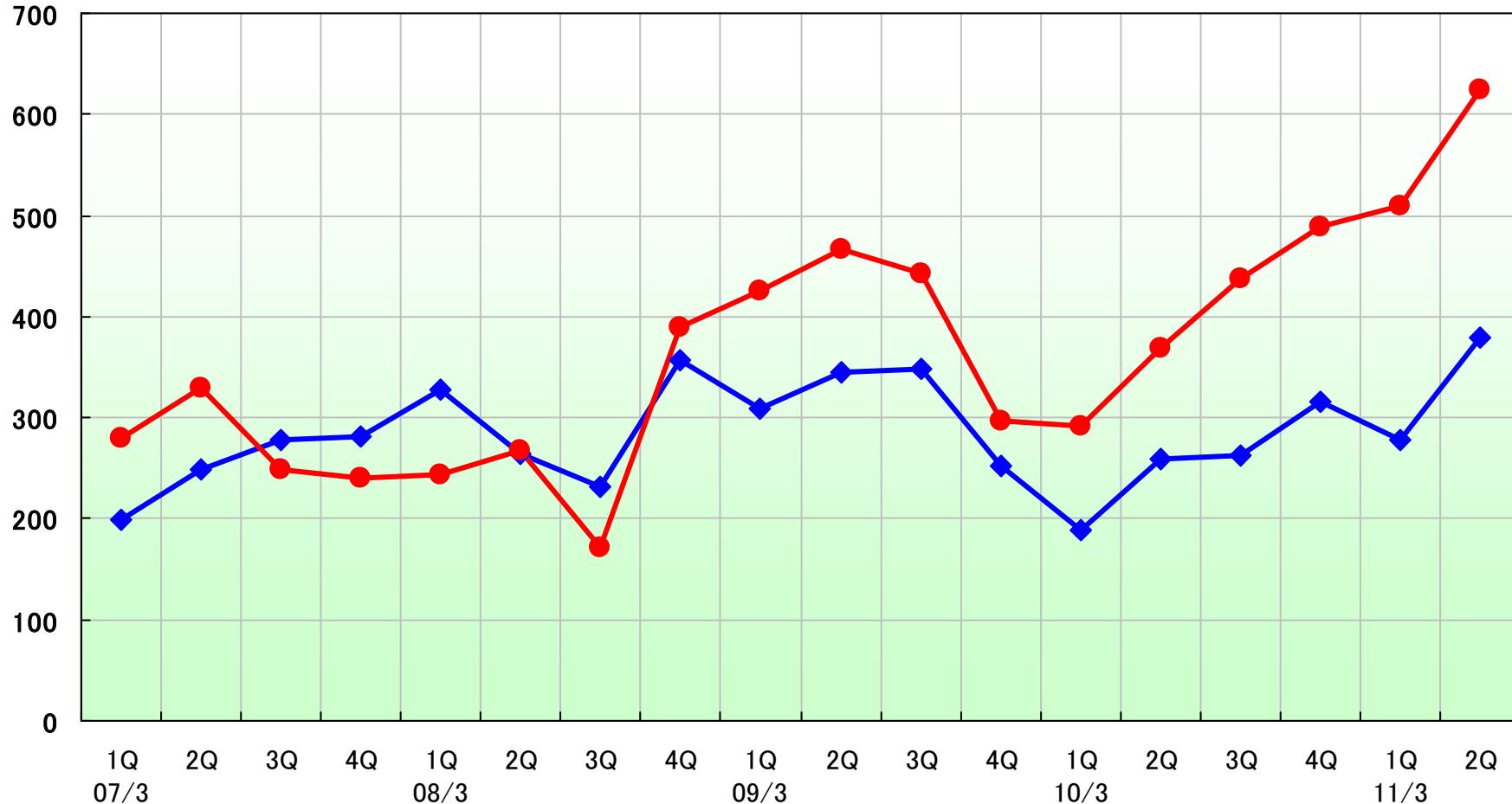


分野別薬品売上高推移:海外マーケット



◆ 基幹薬品 ● 電子薬品

(単位:百万円)



配当状況



	1株当たり配当金		
	中間	期末	年間
11年3月期	27円	27円(予定)	54円(予定)
10年3月期	27円	27円	54円
09年3月期	30円	27円	57円
08年3月期	30円	30円	60円
07年3月期	15円	25円	40円

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために適正な自己資本比率を維持しつつ、業績の状況に応じて配当性向等を勘案し、安定した配当を実施することを基本方針としております。内部留保資金の用途につきましては、今後の事業活動並びに経営基盤の強化に有効活用していく方針であります。

● 2011年3月期第2四半期決算概況

● トピックス



(単位:百万円、%)

決算期	2011年3月期			
項目	第2四半期累計 (実績)	通期に対する 進捗率	通期(予想)	前年同期に 対する増減率
売上高	5, 809	48.2	12, 040	30.9
営業利益	672	51.7	1, 300	146.8
経常利益	660	52.4	1, 260	129.9
四半期(当期) 純利益	319	45.6	700	138.9
1株当たり 当期純利益(円)	87円66銭	—	192円26銭	—

世界の動向から見て、自動車業界とエレクトロニクス業界を成長分野と位置づけ、新規開発商品の市場投入及び顧客への営業の世界展開により市場シェアの拡大を図る。

海外における市場シェア向上のため、海外子会社の拡充により販売ネットワークの充実と海外営業の強化を図る。

熱と誠

市場ニーズを把握し次世代技術の動向を見極めるため、マーケティング部門を強化し、技術開発の効率化と迅速化及び一層の営業サービスの強化を図る。

従来の湿式(ウェット)表面処理技術に加え、乾式(ドライ)表面処理との融合により、一層高密度化、高付加価値化する市場ニーズに対応する。

主な新事業の進捗状況

ボルト・ナット類のコーティング事業

亜鉛めっき後に当社の三価クロメート処置した後、黒色コーティングを施すタイプ

低成本で高耐食性獲得

8月末に 実機納入、現在量産テスト中

スパッタリングによるカラーリング事業 及びハードコーティング事業

中国深圳において、合弁会社深圳森荘真空鍍膜有限公司を設立

携帯電話や時計などの部品へのカラーリング

お客様に依頼された量産テストを順調に実施

自己修復機能のあるコーティング事業もスタート

プラズマ装置事業

国内では大手メーカーに相次いで採用

台湾では実機テスト加工開始

太陽光反射防止膜コーティング事業

台湾の大手太陽光パネルメーカーと共同して、
小型の太陽パネルを使い、性能と耐久性テスト
など20年～25年の保証条件に見合う各種性能
テスト実施中

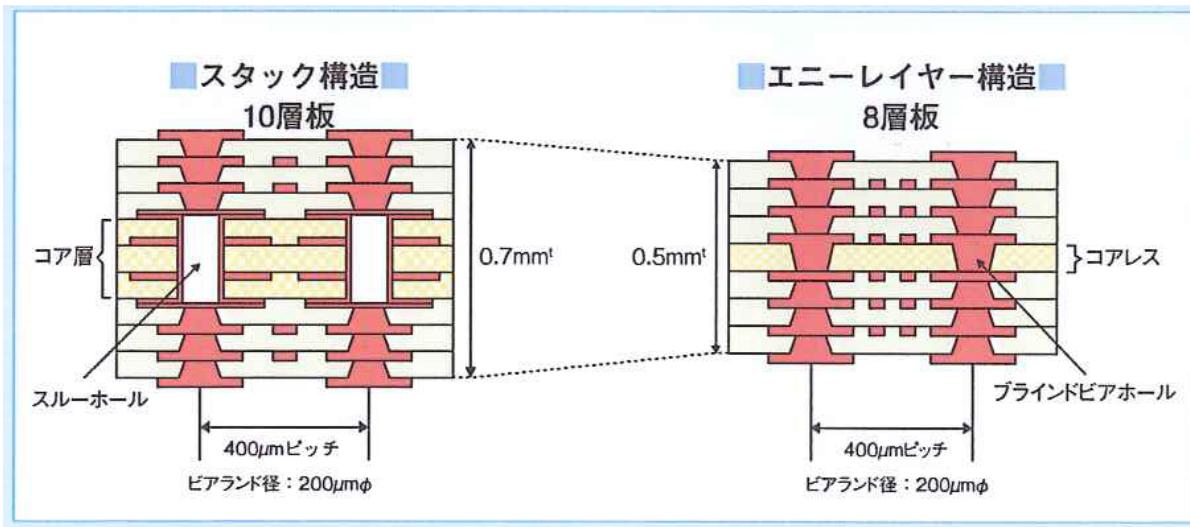
その効果を確認の上で次の段階へ進行

新技術エニーレイヤーが当社業績への影響



エニーレイヤーの定義:

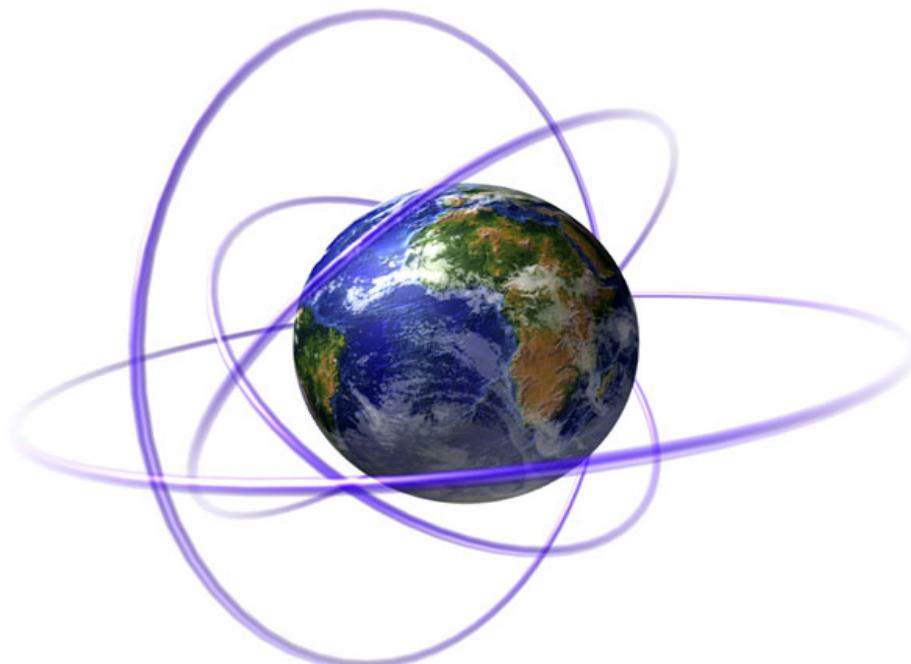
「Any Layer」任意の多段層設計が可能という意味。ビルトアップ基板製造技術においては、従来のスタック構造の場合、スルーホールめつきが必要で、パソコンやデジカメなどの周辺部品には、この方法で十分な性能が得られるが、スマートフォンや電子書籍のような高機能モバイル端末には不十分。エニーレイヤー技術がこの問題を解決するための有力候補として選択され、2010年より一部の製品に採用されている。当社のビアフィリング薬品はこのエニーレイヤーに対応できる技術として市場で好まれている。



特長:

- ・配線設計デザインの自由度が高まる。
- ・配線の密度が向上できる。
- ・従来のスルーホールとブラインドビアホールの両方処理に比べると、ブラインドビアホール工程だけで済むため、大幅にコストの削減ができる。
- ・ビルトアップ基板を薄くできるため、製品の薄型化・軽量化が可能となる。
- ・電気伝導性及び放熱性に優れる。

この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは異なる場合があり、この資料はその実現を確約したり、保証するものではございません。



当社ホームページ:
<http://www.jcu-i.com/>

お問い合わせ先:
TEL: 03-3833-0322
FAX: 03-3833-5075
Mail: ir@jcu-i.com